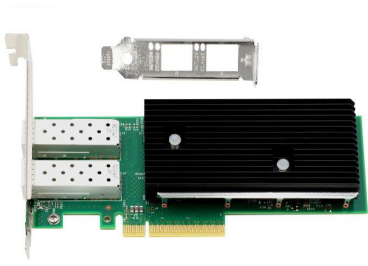


Intel X722-DA2 數據表



英特爾 X722-DA2 10Gbps 雙端口 SFP+ 以太網 PCI Express 3.0 x8 網絡適配器

X722-DA2

英特爾 X722-DA2 10Gbps 雙端口 SFP+ 以太網 PCI Express 3.0 x8 網絡適配器

英特爾以太網網絡適配器 X722 具有 WARP RDMA，可實現高數據吞吐量、低延遲工作負載和低 CPU 利用率。X722 是軟件定義存儲解決方案、NVMe-over-Fabric 解決方案和虛擬機遷移加速的理想選擇。

RDMA 是一種主機卸載、主機旁路技術，可通過網絡在應用程序之間實現低延遲、高吞吐量的直接內存到內存數據通信。

iWARP 對 TCP/IP 的擴展，由互聯網工程任務組 (IETF) 標準化，消除了網絡開銷的三個主要來源：TCP/IP 堆棧進程、內存副本和應用程序上下文切換。WARP 基於 TCP/IP，具有高度可擴展性，是超融合存儲解決方案的理想選擇。

X722 是英特爾以太網 700 系列網絡適配器之一。這些適配器是服務器連接的基礎，為電信、雲和企業 IT 網絡解決方案提供廣泛的互操作性、關鍵性能優化和更高的敏捷性。

- 互操作性——多種媒體類型，廣泛的兼容性得到廣泛測試和驗證的支持。
- 優化 - 智能卸載和加速器，以釋放配備 Intel Xeon 處理器的服務器中的網絡性能。
- Agility - 用於可擴展數據包處理的內核和數據平面開發工具包 (DPDK) 驅動程序。

英特爾以太網 700

系列通過智能卸載、複雜的數據包處理和優質的開源驅動程序，在廣泛的網絡端口速度範圍內提供網絡性能。

特徵

- iWARP RDMA
- PCI Express (PCIe) v3.0, x8
- 網絡虛擬化卸載：VxLAN、GENEVE 和 NVGRE
- Intel Ethernet Flow Director 用於基於硬件的應用程序流量控制
- 數據平面開發套件 (DPDK) 針對高效數據包處理進行了優化
- 網絡設備和網絡功能虛擬化 (NFV) 的出色小數據包性能
- 智能卸載以在配備 Intel Xeon 處理器的服務器上實現高性能
- I/O 虛擬化創新，可在虛擬化服務器中實現最佳性能

規格

- 每個端口支持的數據速率
 - 光學：10GbE
 - 直接連接：10GbE
- 總線類型：PCIe 3.0 (8 GT/s)
- 總線寬度：PCIe x8
- 中斷級別：INTA、MSI、MSI-X
- 硬件認證：FCC A、UL、CE、VCCI、BSMI、CTICK、KCC
- 控制器：英特爾 C628 芯片組
- 工作溫度：0 °C 至 55 °C (32 °F 至 131 °F)
- 空氣流動
 - 雙端口
 - 275LFM @ 55 °C 用於光學器件
 - DAC 為 250LFM 55 °C
 - 四端口
 - 325LFM @ 55 °C 用於光學器件
 - 300LFM @ 55 °C DAC
- 儲存溫度：-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)
- 存儲濕度：最大：35 °C 時 90% 非冷凝相對濕度
- LED 指示燈
 - LINK (穩定) 和 ACTIVITY (閃爍)

- LED 顏色 (綠色 = 10Gbps)

物理尺寸

- X722-DA2 薄型：167 毫米 x 69 毫米
- X722-DA4 全高：167 毫米 x 111 毫米
- X722-DA4 薄型：167 mm × 69 mm

產品訂購代碼

- 雙端口，X722DA2，薄型
- Quad 端口，X722DA4FH，全高
- 四端口，X722DA4G1P5，薄型

[立即購買](#)